

“チップ型はんだアシスト”のご紹介

実装部品のはんだ量不足を補うためのツールとして、はんだをチップ形状に成形加工したものを製品化しました。

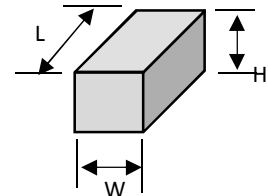
1.用途

実装部品のはんだ量不足が懸念される場所に、補充用はんだとして御使用ください。

2.製品形状

SMD用に各種寸法の製品を用意しました。

製品タイプ	L	W,H
1608	1.6 ±0.05	0.8 ±0.05
1005	1.0 ±0.05	0.5 ±0.05
0603	0.6 ±0.03	0.3 ±0.03



3.梱包仕様

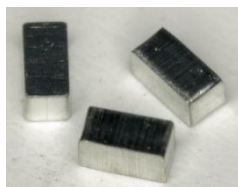
チップ部品と同じテーピング仕様で出荷します。

製品タイプ	φ 180mmリール	φ 330mmリール
1608	送りピッチ 4mm、3,000個入	送りピッチ 4mm、15,000個入
1005	送りピッチ 2mm、10,000個入	送りピッチ 2mm、50,000個入
0603	送りピッチ 2mm、10,000個入	送りピッチ 2mm、50,000個入

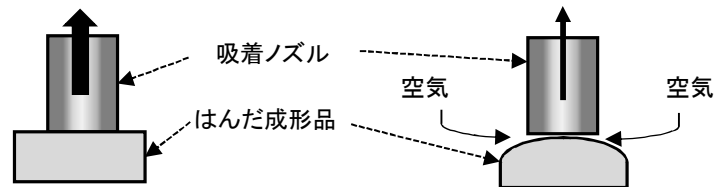
*キャリアテープ幅は8mmで共通です。

4.特長

①独自の工法で平滑な吸着面を形成し、高い搭載精度を実現しました。



(はんだ成形品)



平面は空気が入らず吸着力が強い

曲面は空気が入り吸着力が弱まる



(搭載精度評価サンプル)

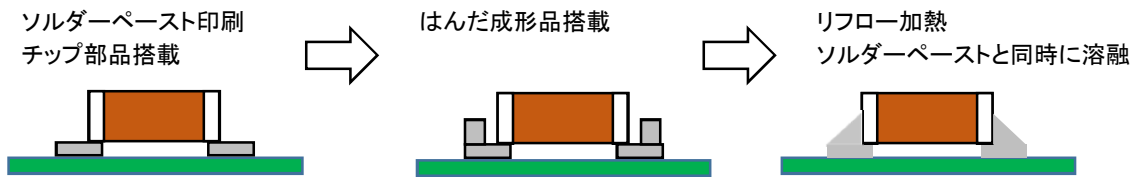


(実用新案登録証 第3190099号)

②チップ部品と同じテーピング仕様なので、SMDと同時に自動搭載が可能です。

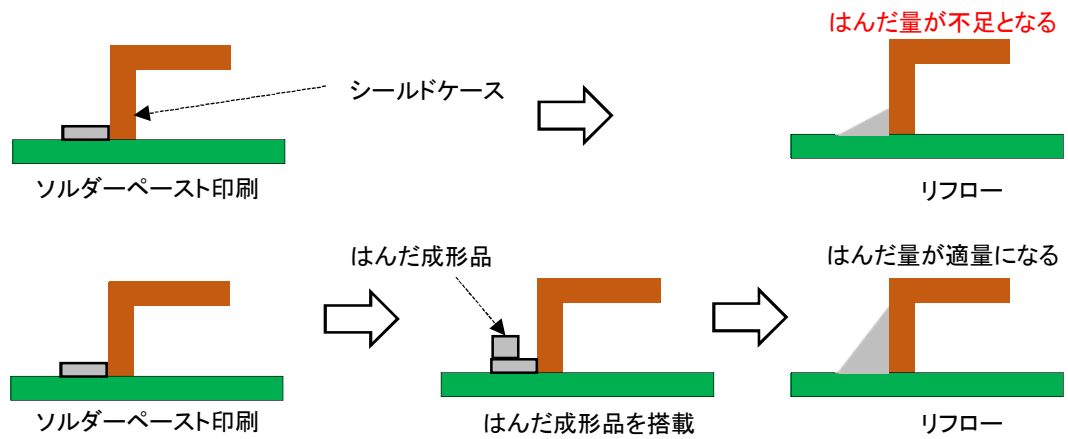


③ソルダーペーストと同時に溶融するため、追いはんだ付けが不要です。



5.適用事例

①大型部品やシールドケースの接合補強に適しています。



②挿入部品のはんだ補充に適しています。

